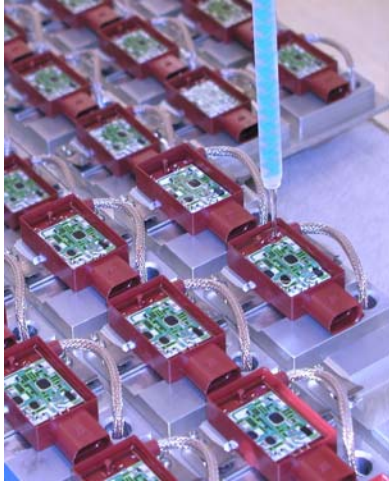


Verguss, Umhüllung und Transfermolden

Weichverguss



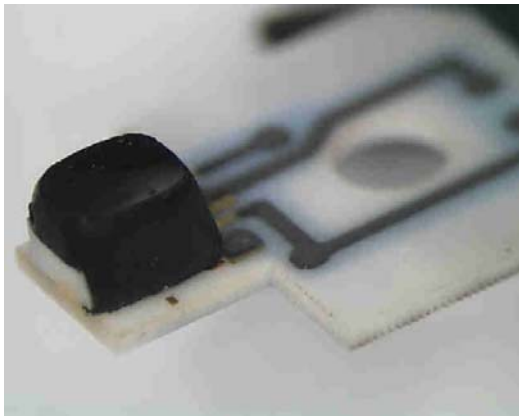
FR5-Leiterplatte mit SMD-Komponenten in Gehäuse eingesetzt, Kontaktstifte eingelötet, vergossen und Deckel mittels Ultraschallschweißverfahren verschlossen

Formstabiler Verguss



Schaltungsaufbau auf IMS-Substrat mit SMD-Komponenten und ungehäustem Leistungshalbleiter
Formstabiler Verguss auf Epoxydharzbasis

Partieller, formstabiler Verguss



3D-Schaltungsaufbau auf Keramik
Sensor in Chip-and Wire Verfahren gebondet
Höhenbegrenzter und formtreuer Verguss

Transfermolden



Keramik bestückt mit ungehäusten Halbleitern und SMD-Komponenten
Angelöteter Lead-Frame und Kühlkörper
Transfermolden der kompletten Baugruppe
Ausstanzen und Biegen der Lead-Frame-Anschlüsse